# 公司概況資料表

以下資料由兆捷科技國際股份有限公司及其推薦證券商提供,資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實,均 由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊,係申請登錄與櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種 因素後所議定。由於與櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動,投資人切勿以上開資訊作 為投資判斷之唯一依據,務請特別注意

- 😥 🕺 認購相關資訊
- 🕑 公司簡介
- 😥 և 風險事項說明(申請登錄戰略新板公司適用)
- 主要業務項目
- 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
- 最近五年度簡明資產負債表
- 👂 最近三年度財務比率

公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司 (股票代號:6959)

申請登錄:■一般板 □戰略新板

1 1/1 2 1/1	17 - 117
董事長	高啓全
總經理	顧大成
資本額	新台幣329,880,000元
輔導推薦證券商	富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	富邦綜合證券股份有限公司 張玉如 (02)8771-6888 分機66672
註冊地國	不適用
訴訟及非訟代理人	不適用

輔導推薦證券商認購 <u>兆捷科技國際股份有限公司</u> 股票之相關資訊								
	主辨	協辨	協辨					
證券商名稱	富邦綜合證券	元大證券	凱基	.證券				
	股份有限公司	股份有限公司	股份有	限公司				
認購日期	112.7.6	112.7.6	112.6.19	112.7.6				
認購股數 (股)	969,000	100,000	70,000	30,000				
認購占擬櫃檯買賣 股份總數之比率	2.94%	0.30%	0.30%					
認購價格	新台幣120元/股	新台幣150元/股	新台幣150/股	新台幣120元/股				
認購價格之訂定 依據及方式	法、成本法及現格,作為本推薦 兆捷科技或該公	商依一般市場認購 金流量折現法等評 證券商認購兆捷科技 司)興櫃股票價格之 、發行市場環境及同	價方式,以推算 支國際股份有限公 上訂定依據;再《	合理之股票價 公司(以下簡稱 參酌該公司產業				

薦證券商與該公司共同議定之。

目前股票價值的評估方法諸多,而各種方法皆有其優缺點,評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括:

- 1.市價法:本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法 (Price/Book Value Ratio, P/B Ratio),均透過已公開的資訊,與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史 軌跡比較,作為評量企業的價值,再根據被評價公司本身 異於採樣公司之部分作折溢價之調整。
- 2.成本法:亦稱帳面價值法(Book Value Method),係以帳面歷史成本 資料作為公司價值評定之基礎。
- 3.收益法:自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF):重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

以上股票評價方法,因成本法係以歷史成本為計算之基礎,易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值,且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響,將可能低估成長型公司應有之價值;另自由現金流量折現法下某些假設,如未來營收成長率、際利潤率、資本支出之假設等,因較難取得適切之數據,使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握,惟股票淨值比法係以公司淨值為計算依據,受經營期間長短、盈餘分配政策、股東權益結構等因素影響,並未考慮公司未來成長性,故此計算方式較不具參考性,該公司屬獲利穩定且成長型類股,故本推薦證券商以本益比法作為評估基準。

兆捷科技主要從事半導體特殊氣體之製造、純化、檢測與質量 控制、分裝與沖填、銷售與儲運等業務,以及特殊氣體容器閥件之 組裝製作。經檢視目前國內上市(櫃)同業資料,尚無與兆捷科技經營 完全相同產品組合之業者,就目前國內上櫃公司晶呈科技股份有限 公司(以下簡稱晶呈科技,股票代號:4768),主要從事半導體及光電 產業之精密化學品製造銷售、原材料、零組件及其設備之進出口買 賣,以生產並銷售半導體產業之前段與封裝、平面顯示器前段等各 類製程所需之特殊氣體為主,與兆捷科技產品性質及應用相似,另 綜合考量所屬產業類別及業務型態等條件後,選取同屬化學工業產 業,臺灣永光化學工業股份有限公司(以下簡稱永光,股票代號: 1711),其主要從事色料、特用、電子、醫藥等化學品及奈米材料產 品之研發、生產及銷售;上市公司三福化工股份有限公司(以下簡稱 三福化,股票代號:4755)主要從事生產半導體、液晶顯示器、觸控 面板、發光二極體及太陽能面板等產業所需之濕式化學品及其他基 礎化學品,作為兆捷科技之採樣同業。茲將上述採樣同業及上市櫃 化學工業類股最近三個月(112年3月~112年5月)之本益比列示如下:

單位:倍

同業\月份\本益比	112年3月	112年4月	112年5月	最近 三個月平均
晶呈科技(4768)	29.83	28.67	28.31	28.94
永光(1711)	27.65	32.21	38.02	32.63
三福化(4755)	15.42	16.19	21.34	17.65
上市化學工業	17.79	18.21	21.11	19.04

上櫃化學工業 19.95 19.94 23.64 21.18

資料來源:臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

由上表同業比較可知,考量與兆捷科技產品相近之採樣同業及上市上櫃化學工業類股最近三個月平均本益比介於17.65倍~32.63倍之間,若以該公司111年度經會計師查核簽證之財務報告歸屬於兆捷科技之稅後淨利104,737千元,普通股加權平均流通在外股數21,631千股計算,每股稅後盈餘為4.84元作為參考依據,計算價格參考價格區間為85.43~157.93元。經參酌兆捷科技經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之狀況,並考量總體經濟環境因素及市場流動性風險後,本輔導推薦證券商與該公司共同議定之興櫃每股認購價格為120及150元,尚屬合理。

## 公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

#### 一、公司介紹

兆捷科技國際股份有限公司,於民國105年成立,兆捷科技從事電子特殊氣體之製造、純化、檢測與質量控制、分裝與沖填、銷售與儲運等業務,以及特殊氣體容器閥件之組裝製作。兆捷科技之特殊氣體產品共分為電子植入氣體(Dopant Gas)、電子清潔蝕刻氣體(Clean and Etchant Gas)、電子沉積氣體(CVD Thin-Film Gas)及電子雷射氣體(Laser Litho Gas)等四大類產品及設備。截至民國112年5月底止,實收資本額為新台幣329.880千元。

兆捷科技之特用化學氣體製造技術,源於自有專利與方法技術做為基礎,透過不斷的開發改良,並經由合成、純化、混合氣配製、充裝、分析檢測及容器製作處理等多項工藝流程,發展出各種電子客戶所使用的高純產品。本公司已取得 ISO9001認證,及分別擁有中華民國新型專利及美國發明專利智財權,而高階雷射氣體是少數已獲得第三方設備商認證的產品,更進一步在中國大陸布局合作建立沉積氣體生產工廠,為具自有氣體生產及其設備開發能力技術的業者,目前產品已完成多家世界一級半導體及面板客戶認證,深獲各電子大廠的信賴。

## 二、歷史沿革

年度	重要沿革
民國 105年	● 兆捷科技國際有限公司成立。
民國 106年	● 生產台灣第一支裝載 AsH3 負壓鋼瓶載具,並開始國內科技大廠認證作業。
民國 107年	● 8 月湖口工廠完工。 ● 9 月湖口廠取得毒化物核准執照,生產台灣第一支 BF3 負壓鋼瓶。
民國 108年	●1 月完成機械相關工程並取得營業生產執照、氣體安全認證及 ISO 9001 認證。 ●3 月研發生產 PH3,且 AsH3 於國內科技大廠完成認證程序。 ●9月 AsH3、BF3、PH3 在國內科技大廠完成認證程序。
民國 109年	<ul><li>●啟動國內科技大廠認證,並完成現金增資資本額至1.2億元整,用於充實營運資金、增聘新進人員及擴充儲存設備。</li><li>●獲得國內科技大廠認證及銷售訂單,同時擴展啟動科技大廠其他廠區認證程序。</li></ul>
民國 110年	● 3 月現金增資資本額至 1.4 億元整。 ● 10 月完成併購泰實公司。 ● 新產品 BF3/H2 於國內科技大廠認證,並增加清潔、沉積、雷射氣體產品產線,規劃產品線落地生產,入駐竹科銅鑼園區。

- ●竹科銅鑼廠區動土。
- 3 月取得泰實公司 100%股權。

民國 111年

- ●7月竹科銅鑼廠區動土。
- ●8月完成現金增資資本額至2.75億元。
- 12 月完成現金增資資本額至 3.24 億元。
- 12 月完成國內科技大廠 BF3/H2 認證。

## 三、經營理念

兆捷科技具多年的特用氣體開發之研發經驗與實力,整合氣體製程之應用技術與經驗,結合自行開發之專利技術,提供客戶完善之特用氣體產品。公司持續創造及維持其經營理念:

#### (一)企業永續經營

兆捷科技配合政府「半導體材料技術自主化」之目標,於2020年經科技部通過審核同意並已發函進駐新竹科學園區之銅鑼科學園區,此用地規劃擴充建廠用途,並具保稅用途,可快速提升公司產能及營收實現台灣技術自主化並銷售至全球海外市場。

## (二)技術自主化及生產在地化

兆捷科技已完成所有植入氣體產品研發及客戶認證,繼續以兆捷科技優秀之技術能力,繼續研發擴散氣體 PH3/H2、B2H6,以利完整參雜氣體之產品項目,並繼續提高各項產品品質規格,邁向合成純化設備製造,落實技術自主化,生產在地化。

#### (三)高度競爭力

將透過策略技術合作方式與國際上具有電子特氣核心技術之公司或團隊進行產品在地化合作,以兆捷科技完善之特用氣體產品專業管理,可快速取得國際上的在地廠家進行代理兆捷科技產品銷售,利用國際上在地公司的通路及地利優勢,搶佔市場先機。

兆捷科技基於對寄予產業發展之趨勢,以及地緣政治之洞悉,兆捷科技持續遵循 及配合國家產業政策重大指標來邁進,對於公司之營業目標是「以成為亞洲最大的半 導體產業電子特氣原物料提供商」。

## 四、未來展望

#### (一)短期業務發展計畫

- 完成銅鑼新廠建造及取得所需之相關證照,繼續在客戶不同的產線認證並擴大市 占率。
- 2.建立矽基、氟基及碳氧基氣體之製造純化、充填及分析的技術能力。

短期目標主要以完成新廠建設、打開市場通路、提升覆蓋率為目標再拓展客戶不同製程應用提高滲透率,提升產品銷售量。並以通過認證客戶之時,利用兆捷科技各項完善設施與資源,如危化品保稅倉儲、品保、檢驗、緊急應變等,代理銷售相關類別之特氣產品,可提高營收,增加收益。

### (二)中長期業務發展計畫

主要是加深供應鏈的深度與廣度,成為台灣最大之特用氣體公司,計劃將電子植入氣體產品在台灣市佔率由5%提升到20%,完成建立矽基、氟基及碳氧基氣體的客戶認證,並有10%以上之市場占有率。完成 ISO17025之製造分析中心以維持業務拓展成長之核心重點。

利用兆捷科技資源及自有客戶通路優勢打造特用氣體銷售平台,設定高階特殊 製程所需的特氣產品為目標市場,與全世界的特氣生產商進行產品代理、分裝銷 售、原料純化、合作生產等,形成產業策略合作聯盟。

## 風險事項說明(登錄戰略新板公司適用)

本公司非屬登錄戰略新板公司,故不適用。

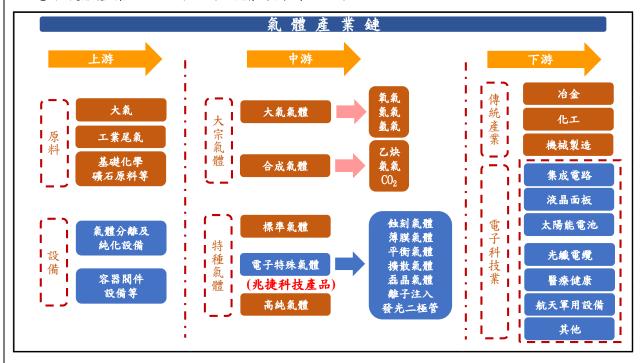
TOP ^

## 主要業務項目:

主要係從事半導體特殊氣體之製造、純化、檢測與質量控制、分裝與沖填、銷售與儲 運等業務,以及特殊氣體容器閥件之組裝製作。

## 公司所屬產業之上、中、下游結構圖:

電子氣體產業之上、中、下游關聯圖列示如下:



產品名稱	產品圖示 及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額(千元)	佔總營收 比重(%)
特殊氣體	lemc  F <sub>2</sub> / N <sub>2</sub> Mixture Gas  Silane SiH <sub>4</sub> H H H H H H H H H H H H H H H H H H	①電子植入氣體:在半導體擴散製造中作為半導體離子佈植及摻雜用特殊氣體,主要產品包括砷烷(AsH3)、磷烷(PH3)、三氟化硼(11BF3)及四氟化鍺(GeF4)等。 ②電子清潔蝕刻氣體:主要以提供三氟化氮(NF3)及氟氣、氮氣混合氣體(F2/N2 Mixture Gas)為主,在半導體與液晶面板生產製造領域中用於清潔機台內部製程後表面產生的矽化物,而F2/N2 Mixture Gas則廣泛應用於電子、雷射技術、醫藥器材等領域。 ③電子沉積氣體:主要以提供矽甲烷(Si2H6)、二氯矽烷(DCS)及三氯矽烷(TCS)為主。主要在半導體積體、路沉積(薄膜製程),用來以薄膜沉積提純矽,主要應用產業包括 DRAM、晶圓代工、面板及太陽能等產業。	711,094	75.38

	Laser Annealing Gas	④電子雷射氣體:主要以提供氫化氮(ArF)、 氟化氮(KrF)、Laser Annealing Gas 雷射退 火氣體、氖氣(Ne)及氦氣(Kr)等產品。其主 要產品是光阻製程中使用,給予 EUV 產生 準分子雷射,運用於半導體 DUV(深紫外 光微影)黃光製程及低溫多晶矽(LTPS) 之生產過程。		
機器設備		特殊氣體轉充裝設備	230,632	24.45
其 他		佣金收入	1,681	0.17
		合 計	943,407	100.00

TOPA

## 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位:新臺幣千元

									里 任	1・新量幣十九
項目			ک	年度	107年 (註1)	108年 (註1)	109年	110年	111年	112年截 至 <u>5</u> 月份止 (自結數)(註2)
營	業		收	λ	_	7,681	47,140	354,626	943,407	195,711
營	業		毛	利	_	1,897	5,488	67,690	184,453	47,157
毛	禾	IJ	率	(%)	_	24.70	11.64	19.09	19.55	24.10
營	業	外	收	入	3	9	2,821	147,486	73,702	61,318
營	業	外	支	出	(140)	(690)	(802)	(3,513)	(3,494)	(2,504)
稅	前		損	益	(7,629)	(13,706)	(20,780)	150,069	132,813	62,033
稅	後		損	益	(7,629)	(13,706)	(20,780)	128,950	106,044	46,346
每服	设盈	餘	(元	<u>.</u> ( )	_	_	(6.09)	9.50	4.84	1.40
nn.	現	金属	段利(:	元)	_	_			1	
股利			t利(賞 増資)		_	_				
發放	股	票服	と利( <i>蝅</i> 資)(デ	盈餘	_	_	_	_	_	_

資料來源:各年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

註1:上述各年度財務資料均經會計師查核簽證,107及108年度委由建誠聯合會計師事務所江連財會 計師查核簽證,依我國企業會計準則編製,惟為辦理股票公開發行之需要,自110年度首次依 國際財務報導準則編製,109~110年度財務報告係為首次依國際財務報導準則編製之財務報 表。。

註2:係自結數字,未經會計師查核簽證,因此可能與會計師查核結果存有差異,請投資人於參考時審慎評估。

	最近五年度簡明資產負債表								
								單位	立:新臺幣千元
項	目	_	年	F度	107年 (註1)	108年 (註1)	109年	110年	111年
流	動	資		產	7,760	12,022	57,135	424,587	1,298,863
不	動産、原	薂房	及部	设備	25,780	27,930	37,954	64,721	213,392
無	形	資		產	_		30	41,935	37,249
其	他	資		產	1,002	3,060	12,882	125,631	117,431
資	產	終	]	額	34,542	43,012	108,001	656,874	1,666,935
流	動	分	配	前	20,302	25,435	25,663	295,399	326,313
負	債	分	配	後	20,302	25,435	25,663	295,399	293,352
非	流重	助	負	債	14,423	31,465	5,838	93,403	83,917
負	債	分	配	前	34,725	56,900	31,501	388,802	410,230
總	額	分	配	後	34,725	56,900	31,501	388,802	377,242
股				本	10,000	10,000	120,000	164,940	323,700
資	本	公		積	_	_	1,360	5,349	748,678
保	留	分	配	前	(10,183)	(23,888)	(44,860)	82,676	184,327
盈	餘	分	配	後	(10,183)	(23,888)	(44,860)	82,676	151,339
其	他	權	Ė	益	_	_	_		_
庫	藏	股	Ļ	票	_				_
非	控制	钊	權	益	_	_	_	15,107	_
股	東權益	分	配	前	(183)	(13,888)	76,500	268,072	1,256,705
總	額	分	配	後	(183)	(13,888)	76,500	268,072	1,223,717

資料來源:各年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

註1:上述各年度財務資料均經會計師查核簽證,107及108年度委由建誠聯合會計師事務所江連財會 計師查核簽證,依我國企業會計準則編製,惟為辦理股票公開發行之需要,自110年度首次依 國際財務報導準則編製,109~110年度財務報告係為首次依國際財務報導準則編製之財務報表。 註2:上稱分配後數字,係依據次年股東會決議之情形填列。

TOPA

最近三年度財務比率								
項目	年度	109年	110年	111年				
	毛利率(%)	11.64	19.09	19.55				
財	流動比率(%)	235.07	113.86	292.45				
務	應收帳款天數(天)	94.8	131	73				
比率	存貨週轉天數(天)	7.15	52	81				
+	負債比率(%)	24.94	59.19	24.61				

TOPA